

# 高熱伝導性 銀ペースト

High Thermal Conductive Silver Paste

## 焼結技術により更なる高熱伝導性を実現

Thermal Conductivity is Enhanced by Sintering Technology

### 豊富なラインナップ Various Lineups

- フルシンタリング** Full Sintering → **加圧/無加圧、Air/N2雰囲気下等、プロセスに応じた対応が可能**  
Various processes are available-Press/Non-Press, Air/N2
- ハーフシンタリング** Partial Sintering → **低銀含有率での高熱伝導、かつ、ベアチップ面への高密着を実現**  
High thermal conductivity with low silver content & high adhesion to bare Si chip

